

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구  
국제사무국

(43) 국제공개일

2022년 10월 20일 (20.10.2022) WIPO | PCT



(10) 국제공개번호

WO 2022/220421 A1

- (51) 국제특허분류:  
H04M 1/02 (2006.01) H01Q 1/24 (2006.01)  
H05K 5/00 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2022/003839
- (22) 국제출원일: 2022년 3월 18일 (18.03.2022)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:  
10-2021-0046941 2021년 4월 12일 (12.04.2021) KR
- (71) 출원인: 삼성전자주식회사 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) [KR/KR]; 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR).
- (72) 발명자: 오명수 (OH, Myeongsu); 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR). 김용연 (KIM,

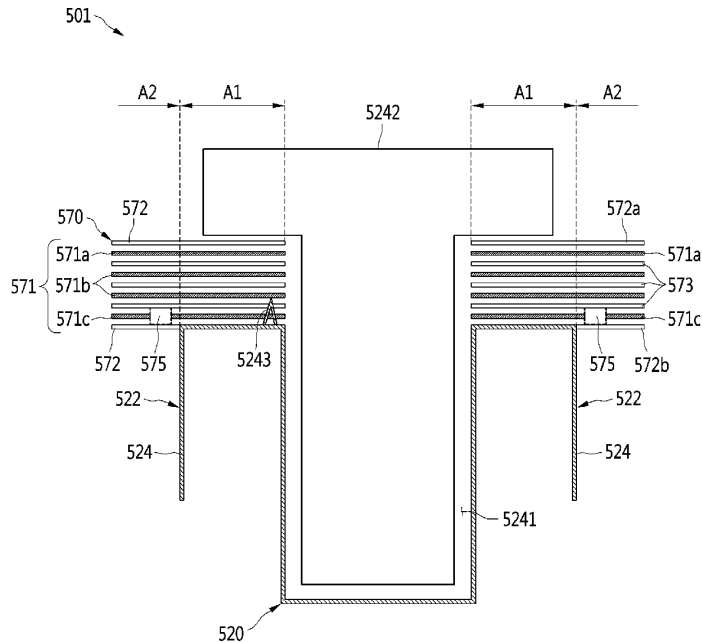
Yongyoun); 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR). 추두호 (CHU, Duho); 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR). 홍영준 (HONG, Youngjune); 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR).

(74) 대리인: 특허법인 무한 (MUHANN PATENT & LAW FIRM); 06144 서울특별시 강남구 언주로 560, 8층 (역삼동, 화물재단빌딩), Seoul (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM,

(54) Title: ELECTRONIC APPARATUS FOR STABLE ELECTRICAL CONNECTION

(54) 발명의 명칭: 안정적인 전기적 연결을 위한 전자 장치



(57) Abstract: An electronic apparatus according to various embodiments comprises: a housing having a coupling region; and a printed circuit board that has an overlap region overlapping the coupling region and a non-overlap region not overlapping the coupling region. The printed circuit board includes a plurality of metal layers and a plurality of lines. The printed circuit board may include a void section in which a portion of at least one metal layer close to the coupling region among the plurality of metal layers is not formed.

(57) 요약서: 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 결합 영역을 갖는 하우징; 및 상기 결합 영역과 오버랩되는 오버랩 영역 및 상기 결합 영역과 오버랩되지 않는 비오버랩 영역을 갖는 인쇄회로기판을 포함하고, 상기 인쇄회로기판은 복수 개의 금속 레이어들 및 복수 개의 라인들을 포함하고, 상기 인쇄회로기판은, 상기 복수 개의 금속 레이어들 중 상기 결합 영역에 가까운 적어도 하나 이상의 금속 레이어의 일 부분이 형성되지 않는 보이드 부분을 포함할 수 있다.

[다음 쪽 계속]



WO 2022/220421 A1

PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))